

WHM1

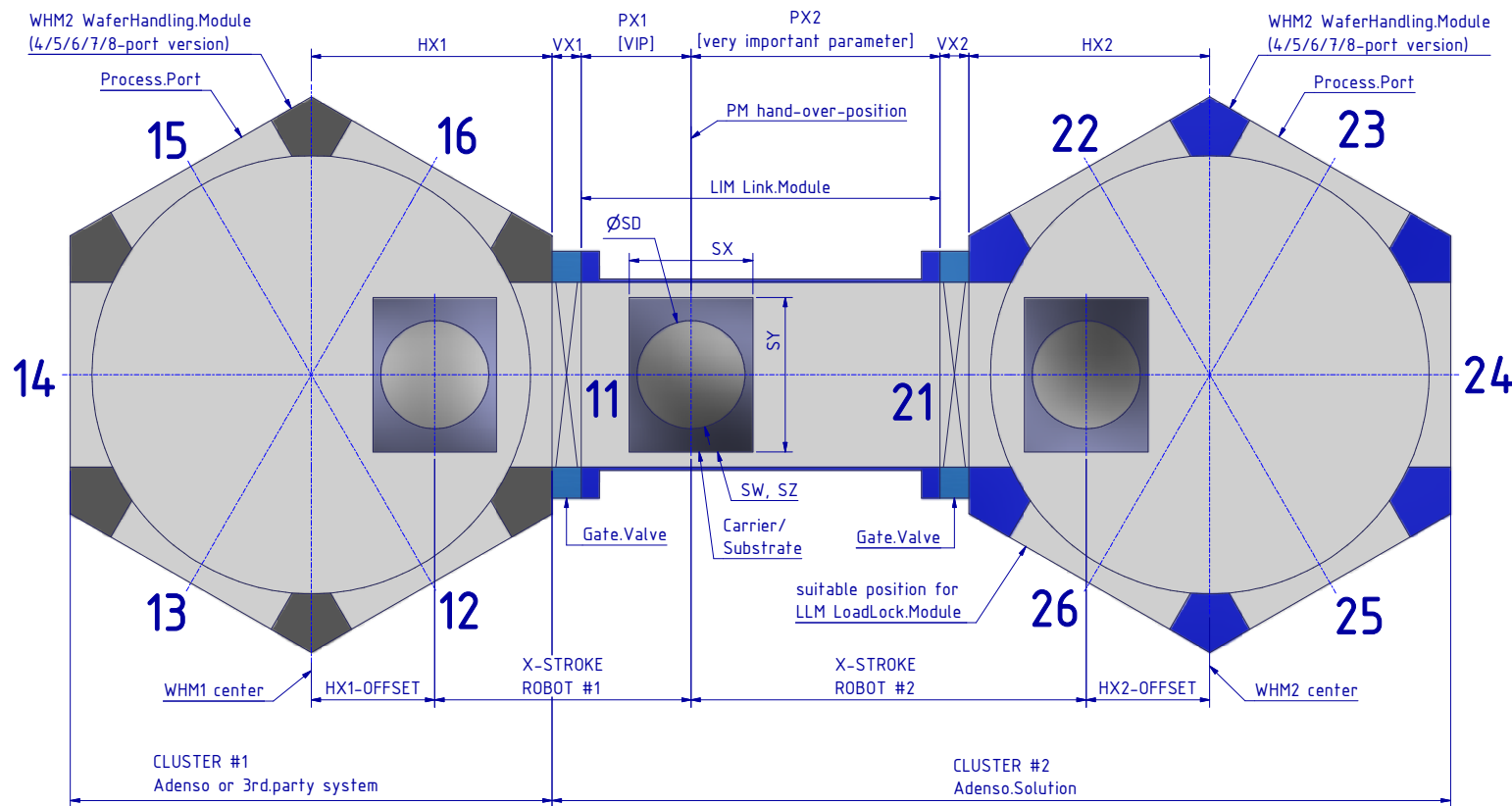
WaferHandling.Module

4/5/6/7/8 ports

WHM2

WaferHandling.Module

4/5/6/7/8 ports



REQUIRED.DIMENSIONS:

Substrate/Carrier.Dimensions:

- rectangular: SX and SY
- circular: \varnothing SD
- thickness: SZ
- substrate/carrier weight (LOAD): SW

Cluster.Layout:

- number of process ports, e.g. 6 pcs. = WHM6X

Process.Dimensions:

- PX = hand-over-position inside process module to outer sealing surface (w/o gate)

Valve.Dimensions:

- VX = valve thickness
- VY = valve width (opening)
- VZ = valva high (opening)

Additional.Dimensions (if available):

- LIM = dimensions of Link.Module

Informal.Dimensions:

- HX = sealing surface to center (WHM)

www.waferhandling.solutions

Positionstoleranz / tolerances of location 1 Bohrungen / holes 0,1 mm 1 Gewinde / threads 0,1 mm 1 Passungen / fits 0,01 mm		Kanten mit unbestimmter Form nach DIN ISO 13715 $+0,3$ $+0,1$ $-0,1$ $-0,3$		Allgem. Toleranz nach DIN ISO 2768 Längen und Winkelmaß m Form und Lage Allg.-Teil Schweißkonst. nach DIN ISO 2768 Längen und Winkelmaß β Form und Lage		Prüfnähe nach DIN 466-11 Toleranzgrundsatz nach ISO 8015 Bewertungsgruppe für Unregelmäßigkeiten (Schweißverbindung) DIN EN ISO 5817 c	
projection ISO 128 - method 1 		Oberflächenbeschaffenheit nach DIN EN ISO 1302 Vakuum-Dichtflächen keine Rillen und Riefen quer zum Dichtungsverlauf zulässig Rz 6,3		Maßstab: 1 : 5 Halbzeug:		Masse: 10,1 kg Material/Oberfläche: Allgemein	
		Datum Name Gezeichnet 20.02.2020 BC Freigegeben		Benennung adCLUSTER advanced MultiCluster.Solutions required dimensions			
		Status Änderungen Datum Name 02 update 20.09.22 BC 01 update 15.09.21 BC		Zeichnungsnr. 188-200000-69		Revision 02 1 / 1 A2	
		Status Änderungen Datum Name 188-200000-69.rdw		Ersatz für:		Ersatz durch:	